

## 电子行业周报（10.07-10.13）

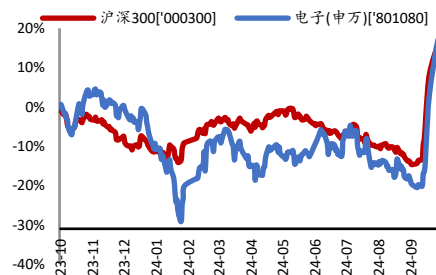
### 联想科技大会发布在即，AI终端加速推进

#### 投资要点：

- **24Q3全球PC出货量实现连续增长，有望持续复苏。**据集微网转引Canalys 10月10日最新公布的研究报告数据显示，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，全球PC市场（包括台式机、笔记本和 workstation）总出货量增长1.3%，达到6640万台。而未来12个月PC市场将继续保持强劲增长，主要系2025年10月Windows 10服务终止前，仍有大量的Windows PC装机需求，以及AI PC等创新趋势的持续驱动。从具体的品牌厂商排名来看，联想位居榜首，全球出货量达到1650万台，同比增长2.8%；惠普、戴尔、华硕、苹果位居其后。Canalys首席分析师表示，第三季度的增长较温和，但PC市场的复苏已全面展开，一些积极信号表明未来几个季度的表现将更加强劲。
- **全球六大AI巨头将齐聚2024联想Tech World，AI PC持续渗透。**2024年AI PC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商纷纷布局大模型时代的AI PC产品，而英特尔、AMD和高通推出的最新AI PC处理器也不断强化升级AI落地PC的价值主张。2024年10月15日，NVIDIA、英特尔、微软、AMD、Meta、高通等全球顶尖AI科技企业将齐聚联想创新科技大会，共同加速AI PC落地并深入渗透到个人与企业的真实应用场景。自2023年以来，生成式人工智能已从一项新兴技术发展成为消费者行为的核心驱动力，改变了决策过程并塑造了品牌期望。据Canalys数据，工作场所的AI应用推动了AI设备的需求，预计2025年AI PC出货量将增长204%，企业需求激增310%，主要集中在文本和图像生成、会议纪要等生产力工具上。联想与众AI巨头协力加速AI端侧落地应用，促进产业链协同发展，将进一步撬动PC市场的加速成长。
- **投资建议：**AI PC方向，建议关注：1) 芯片：AMD（美股）、通富微电、龙芯中科；2) 显示面板：TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电等；3) 结构件/零部件：春秋电子、福蓉科技、英力股份、胜宏科技、珠海冠宇等；4) 散热：飞荣达、思泉新材等；5) 制造：华勤技术、闻泰科技等。
- **风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

### 强于大市（维持评级）

#### 一年内行业相对大盘走势



#### 电子行业估值（PE）



#### 团队成员

分析师 杨钟  
 执业证书编号：S0210522110003  
 邮箱：yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小瑁  
 邮箱：zxm30169@hfzq.com.cn

#### 相关报告

- 《半导体设备年会顺利召开，核心技术国产化提速》——2024.9.29
- 《65纳米光刻机突破，半导体设备国产化提速》——2024.09.22
- 《关注端侧 AI+折叠屏等创新技术的加速渗透》——2024.09.15



## 正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现 .....	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	6
2.3	消费电子板块.....	9
2.4	汽车电子板块.....	13
2.5	面板板块.....	14
三、	公司动态跟踪.....	15
四、	风险提示.....	20

## 图表目录

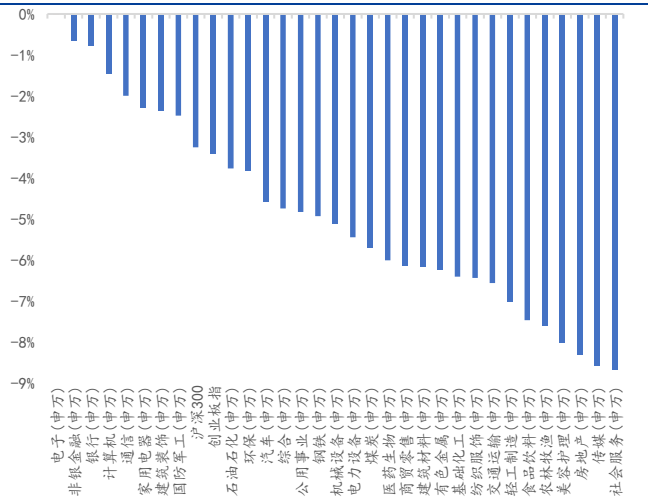
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%) .....	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%) .....	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%) .....	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%) .....	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM) .....	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM) .....	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新 .....	17
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	20

## 一、 本周市场表现

### 1.1 电子板块本周表现

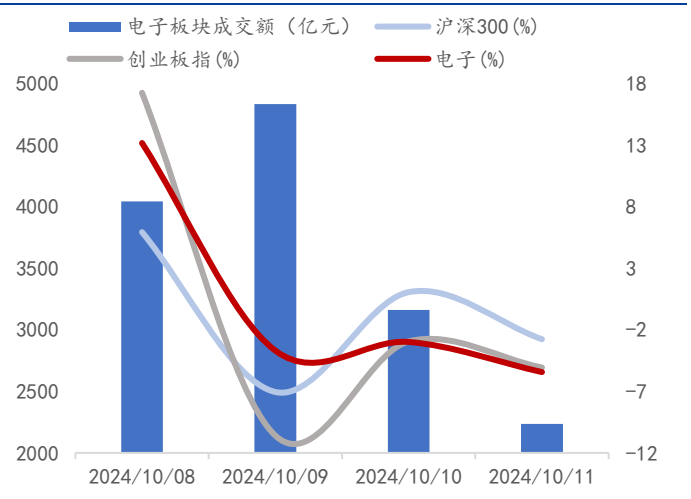
大盘表现上，本周（1007-1013）创业板指数下跌 3.41%，沪深 300 指数下跌 3.25%。本周电子行业指数下跌 0.02%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 1 位，本周非银金融、银行、计算机板块涨跌幅也位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

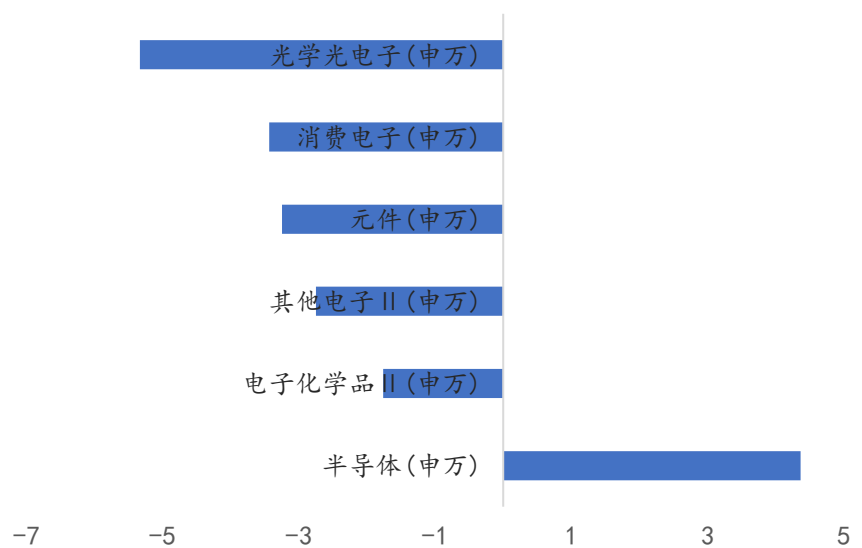
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块涨跌幅分化，具体来看，半导体板块领涨，周涨跌幅为 4.37%；光学光电子板块跌幅最大，周涨跌幅为-5.33%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%）



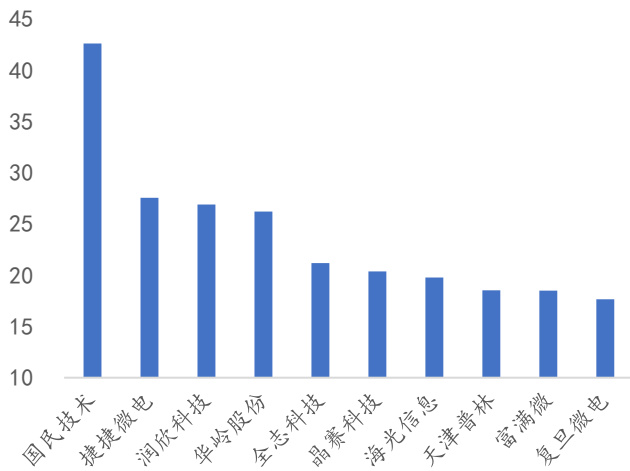
数据来源：Wind，华福证券研究所

### 1.2 SW 电子个股本周表现

从个股维度来看，SW 电子板块中，国民技术（42.59%）、捷捷微电（27.54%）

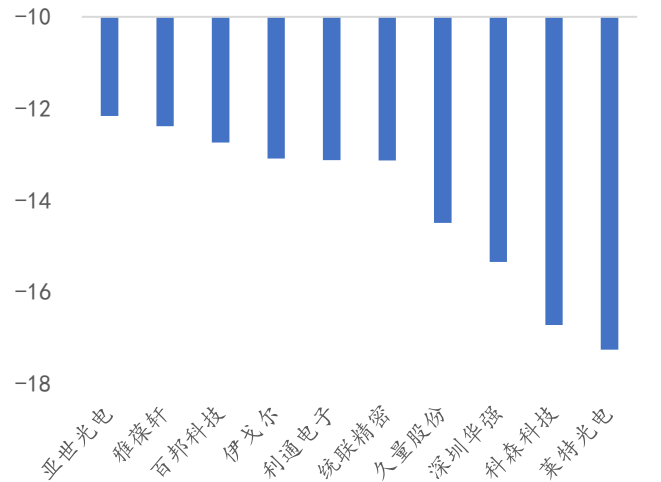
等位列涨幅前列；莱特光电（-17.26%）、科森科技（-16.72%）等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

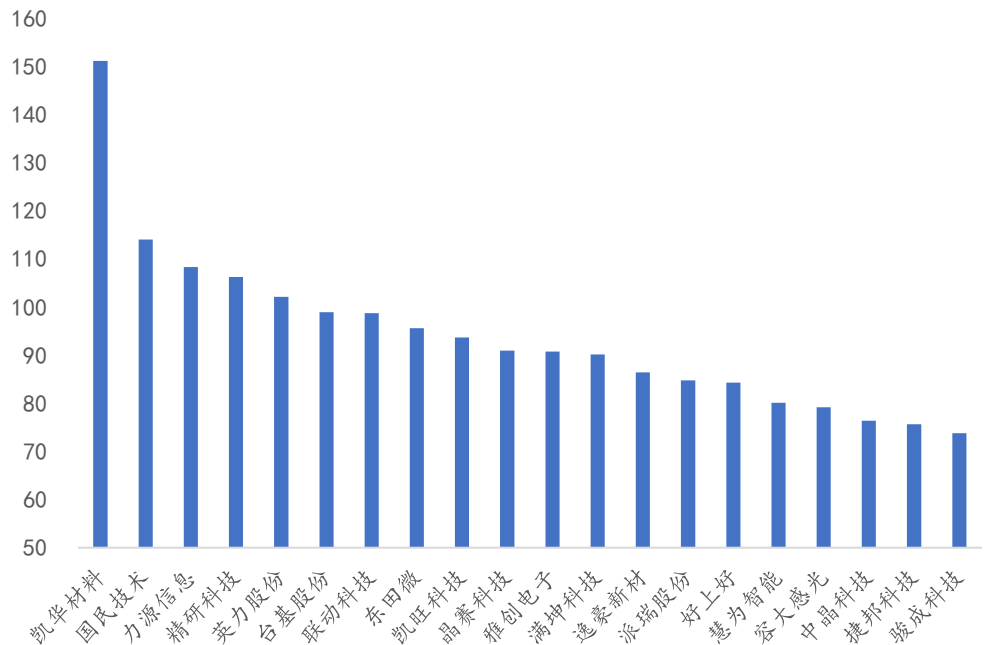
图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

从换手率来看，本周电子行业个股换手率最高的是凯华材料，换手率为 151.12%。其余换手率较高的还有国民技术（114.02%）、力源信息（108.31%）、精研科技（106.23%）。

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%）

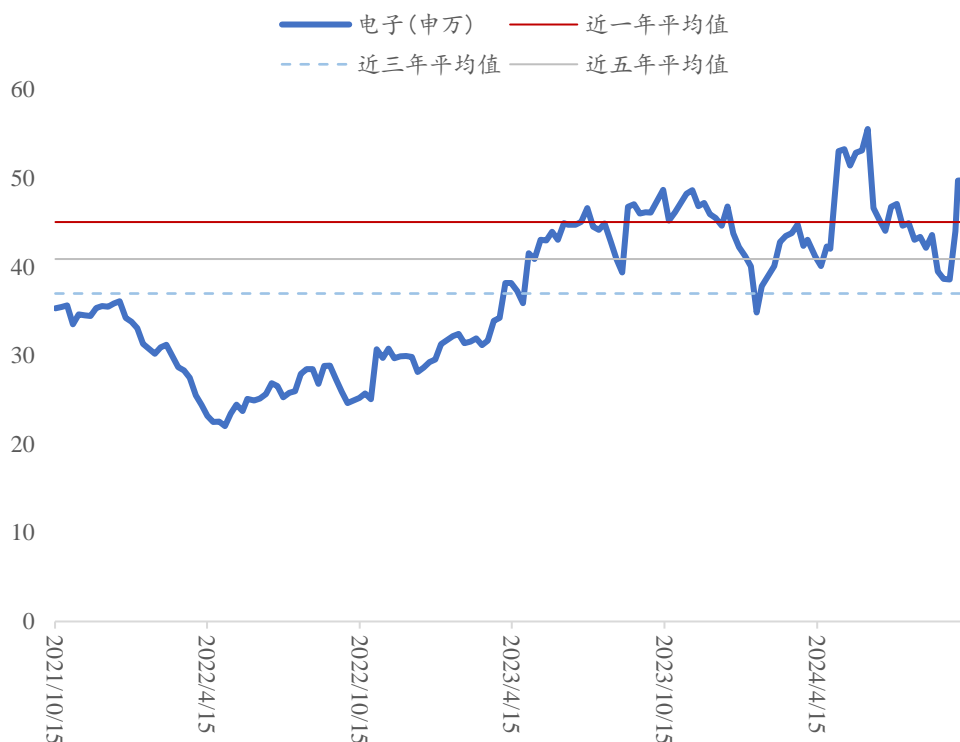


数据来源：Wind，华福证券研究所

### 1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看，整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 49.76 倍，较上周有所上调。

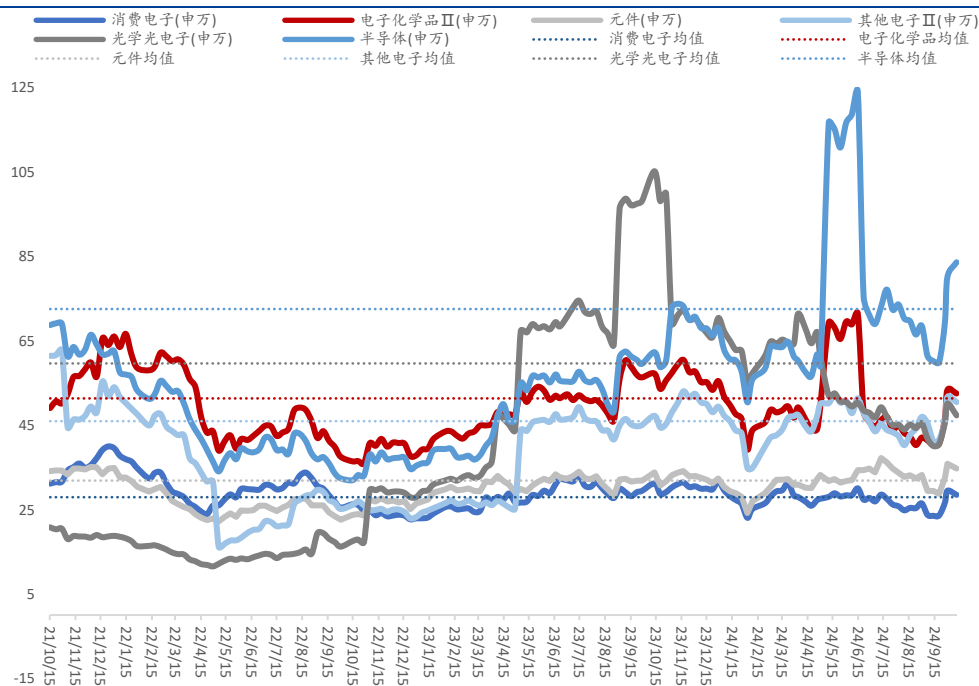
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 28.47、52.48、34.74、50.43、47.29 和 83.57, 本周电子细分板块估值除半导体外均有一定程度下降。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

## 二、 行业动态跟踪

### 2.1 半导体板块

#### 1) 三星 10 月 24 日携手 Arm、Groq 举办中国“2024 年晶圆代工论坛”

三星电子将于 10 月 24 日举办中国“2024 三星晶圆代工论坛”（SFF）。该活动旨在展示其尖端晶圆代工技术和人工智能（AI）竞争力，同时加强与 Arm 等重要合作伙伴的关系。三星电子总裁兼晶圆代工业务负责人 Choi Si-young、Arm 首席执行官 Rene Haas 和 Groq 创始人 Jonathan Ross 将出席此次论坛，但该论坛已转移到线上举行。

该论坛将成为三星积极推广其 3nm 以下先进代工技术和提升 AI 技术竞争力的平台。泰克科技、至上电子等主要合作伙伴，以及中芯国际、华虹半导体等重要的晶圆代工企业都在密切关注这一盛会。中国晶圆代工企业正在逐步扩大市场份额。

中国市场仍然是三星电子最大的收入来源之一。第一季度，该公司在中国的销售额达到 14.7546 万亿韩元（约合 113.4 亿美元），超过美洲（14.1301 万亿韩元）和欧洲（7.4994 万亿韩元）的销售额。中国客户对台积电以外的代工来源多样化的需求也在不断增加。（资料来源：集微网）

#### 2) 高通骁龙 X Elite 芯片图像曝光：拥有巨大 CPU 核心和海量缓存

爆料人士在百度贴吧上发布了一张带注释的芯片照片，据称是高通骁龙 X Elite 处理器。图片显示了巨大的 CPU 核心、中等大小的 GPU 和巨大的缓存。不过，芯片照片没有显示出 45TOPS 算力的 NPU（神经处理单元），高通称这是这款 SoC 的主要卖点。

爆料人士表示，12 核骁龙 X Elite 的芯片尺寸为 169.6 平方毫米。这比苹果的 10 核 M4（165.9 平方毫米）略大。然而，需要注意的是，高通的骁龙 X Elite 采用台积电 N4P 工艺技术（实际 5nm 节点）制造，而苹果 M4 采用台积电 N3E（3nm 工艺）制造技术。

骁龙 X 最引人注目的是其庞大的通用 Oryon CPU 内核（代号为 Phoenix，最初由 Nuvia 为其数据中心级处理器开发），运行频率高达 3.80 GHz。据泄密者称，每个 Oryon 内核的面积约为 2.55 平方毫米，这比典型的 Arm CPU 内核大得多。然而，苹果在 M4 中使用的高性能通用 CPU 内核的面积约为 3 平方毫米，考虑到制程技术的差异，很明显苹果的 M4 高性能 Arm 内核比 Oryon 更复杂。

另一个引人注目的地方是巨大的缓存：骁龙 X Elite 处理器有 3 个四核 CPU 集群，每个集群具有 12MB 12 路 L2 缓存、6MB 系统级缓存，然后 GPU 有自己的约 12MB 缓存（分布在多个级别）。总的来说，CPU 有 54MB 的各种缓存，占用约 15 平方毫米的芯片尺寸。（资料来源：集微网）

### 3) AMD 推出 MI325X 人工智能芯片、新款数据中心 CPU

AMD (AMD-US) 周四 (10 日) 在旧金山举办的活动上表示, 计划在今年第四季开始大规模生产名为“MI325X”的新版人工智能 (AI) 芯片。该款芯片与英伟达 (NVDA-US) 的 Blackwell 的较劲。

不只如此, AMD 还打算在明年下半年推出下一代 MI350 系列芯片, 除了更大的记忆体, 还有新的底层架构。该公司称, 与之前的 MI300X 和 MI250X 芯片相比, MI350 架构将显著提高性能。

有分析称, 在 AI 加速器市场上, AMD 远远落后于业界老大英伟达屈居第二, 这个格局短时间内不会被改变。由于 AI 芯片的需求远远超过供应量, AMD 周四推出的新产品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。(资料来源: 集微网)

### 4) 总投资 1 亿美元, 罗杰斯高功率半导体陶瓷基板苏州新生产基地投产

据苏州工业园区发布消息, 10 月 11 日, 罗杰斯规划总投资 1 亿美元的高端半导体功率模块陶瓷基板研发制造项目在苏州工业园区开业。

罗杰斯在高端半导体功率模块陶瓷基板研发制造领域全球领先、市场份额超过 40%, 产品主要应用于新能源汽车领域和可再生能源领域, 客户包括特斯拉、英飞凌、大陆、博世、比亚迪等业内头部企业。

此次投资设立的高端半导体功率模块陶瓷基板研发制造项目, 罗杰斯电子材料 (苏州) 有限公司规划总投资 1 亿美元, 其中一期项目投资 3000 万美元, 厂区面积达 15000 平方米, 预计在 2025 年中旬实现全面交付, 未来达产后年营收可达 2 亿美元规模。投产后, 将有助于缩短交付周期, 深化罗杰斯与亚洲客户之间的技术合作, 更大程度地满足 EV/HEV 和可再生能源等应用中日益增长的金属化陶瓷基板的需求。(资料来源: 集微网)

### 5) 英伟达 Blackwell GPU 产品未来一年订单已满

摩根士丹利 (大摩) 表示, 人工智能 (AI) 芯片霸主英伟达 (NVIDIA) 管理阶层最近披露, 下一代绘图处理器 (GPU) Blackwell 需求强劲, 「未来 12 个月已被订光」, 看好英伟达股价可望刷新纪录。

大摩本周为英伟达执行长黄仁勋和其他英伟达主管, 举办与投资人之间的一系列会议, 英伟达主管群透露, Blackwell GPU 产品「未来 12 个月已被订光」, 代表如果有客户现在才下单, 要到明年底才能收到产品。会议资料显示, 英伟达数据中心事业依然畅旺, Blackwell 未来的能见度非常高, 乐观看好英伟达股价将再刷新纪录。

大摩说, Blackwell 等待出货时间漫长, 不只是 Blackwell 需求强劲的讯号, 也暗示 Hopper 产品线需求将持续热络, 客户急需下, 可能改买 Hopper 芯片, 「预示了未来一年的出货量将维持高成长」。(资料来源: 集微网)

## 6) AMD 苏姿丰预期：2028 年 AI 芯片市场规模将达到 5,000 亿美元

资料中心 AI 加速器市场前景大好，超微（AMD）董事长暨执行长苏姿丰再度更新对相关潜在市场规模（TAM）的预估，她估计到 2028 年时，资料中心 AI 加速器 TAM 将达 5,000 亿美元，从 2023 至 2028 年间的相关年复合成长率将超过 60%。

苏姿丰预期，AI 需求持续成长，产业「才刚开始」采用 AI 技术，整体 AI 芯片市场以 60% 的年均复合成长率的速度扩张，到 2028 年将达到 5,000 亿美元。苏姿丰先前认为，到 2027 年 AI 芯片的市场规模将达到 4,000 亿美元。（资料来源：集微网）

## 7) “MCU+AI” 市场兴起，国产 MCU 成长加速

作为相对成熟的芯片类别，微控制器（MCU）的市场态势相对稳定，但随着边缘 AI 的兴起，近年也迎来一轮新的市场机会。市调机构 Yole Group 近日指出，2023 年全球 MCU 市场规模 282 亿美元，预计到 2029 年成长为 388 亿美元，年复合增长率达 5.5%。而这也给中国厂商快速崛起带来新的契机。

### 需求稳中有升，国产 MCU 成长加速

在智能物联、智能家居、汽车电子等新兴领域快速发展之下，MCU 的应用场景不断拓宽，推动了对 MCU 产品的需求增长。根据 Yole 的研究报告显示，2023 年全球 MCU 市场规模约 282 亿美元，预计至 2028 年将以 5.5% 的年复合增速达到 388 亿美元。Precedence Research 的数据显示，2022 年全球 MCU 市场为 282 亿美元，预计 2030 年有望达 582 亿美元。中国市场方面，2022 年中国 MCU 市场规模约为 390 亿元，预计 2026 年将有望突破 500 亿元，未来增长前景广阔。

从价格走势上看，Yole Group 认为，几年前的新冠肺炎大流行导致供应链中断，再加上晶圆厂产能短缺与囤货行为，显著推升了 MCU 的 ASP（平均销售价格）。ASP 从 2020 年的约 0.6 美元，涨至 2023 年的 0.93 美元。不过 Yole Group 也指出，近年来新供应商尤其是中国供应商崛起，将有助于缓解先前供应链问题导致的 ASP 升高。

近年来，来自中国的 MCU 供应商加速成长，逐渐在国内外市场中崭露头角，成为 MCU 市场的一大变量。据了解，目前国产 MCU 在工艺制造上已覆盖至 28nm 制程，展现出与国际接轨的潜力。全球 MCU 制造目前主要集中于 40nm 及以上的成熟制程工艺节点，比较先进的车用 MCU 产品可能会部分采用 28nm 制程。这已在国内代工厂的工艺节点覆盖范围。随着代工厂在 28nm 技术的持续优化，国内 MCU 厂商与代工厂加强协作，将推动国产 MCU 性能再上一个台阶。

### “MCU+AI” 市场兴起 提供发展新契机

边缘 AI 的兴起则为中国 MCU 供应商提供了新的发展机遇。近年来，物联网设备数量迅速增加。机构数据显示，2022 年全球物联网设备约为 300 亿台，预计到 2027

年将达到 430 亿台，每秒大约有 127 台设备首次接入物联网。如果从数据上看，2025 年物联网设备生成数据量将达到 79.4ZB。如果将这些数据都推到云端处理，不仅推理成本高、能耗大，而且存在数据传输延迟增加、数据安全风险加大等因素，在端侧进行 AI 处理，是加速智能化应用落地的重要抓手。

### RISC-V 架构助力 50%增速引关注

在边缘 AI 兴起的背景下，RISC-V 架构加速应用也推动了国内 MCU 产业的成长。研究机构 Omdia 最新研究显示，预计到 2030 年，RISC-V 处理器将占据全球市场近四分之一的份额。该机构预测，在 2024~2025 年间，基于 RISC-V 架构的处理器出货量将以每年近 50% 的速度增长，到 2030 年出货量将达到 170 亿颗。达摩院（上海）科技有限公司研发总监梁中书认为，毫无疑问 RISC-V 如今最重要的方向就是 AI。AI 的算力必然会走向端用化，AI 大算力的芯片形态应该是一个“松耦合”的状态，用 RISC-V 内核+相关 AI 加速器。（资料来源：集微网）

### 8) SEMI：电子系统设计行业 Q2 收入达 47 亿美元

SEMI 技术社区 ESD 联盟在其最新的电子设计市场数据（EDMD）报告中宣布，2024 年第二季度电子系统设计（ESD）行业收入从 2023 年第二季度的 39.627 亿美元增至 46.855 亿美元，增长了 18.2%。最近四个季度比前四个季度的移动平均值增长了 18%。

SEMI 电子设计市场数据报告的执行发起人 Walden C. Rhines 表示：“电子设计自动化（EDA）行业在 2024 年第二季度的收入大幅增长。所有产品类别都实现了增长，其中集成电路物理和半导体 IP 与服务实现了两位数的增长。此外，所有地区都实现了两位数的增长。”

EDMD 季度报告包含详细的收入信息，其中包括以下类别和地区细分。

按产品和应用类别划分的收入 - 2024 年第二季度同比变化情况

2024 年第二季度，计算机辅助工程（CAE）收入增长 8.9%，达到 16.464 亿美元。四个季度的 CAE 移动平均值增长了 16%。

集成电路物理设计与验证收入增长 13.1%，达到 7.793 亿美元。该类别的四季度移动平均值增长了 17.1%。

印刷电路板和多芯片模块（PCB 和 MCM）收入增长 8.2%，达到 3.992 亿美元。印刷电路板和多芯片模块的四季度移动平均值增长了 13.6%。

半导体知识产权（SIP）收入猛增 33.9%，达到 16.807 亿美元。四季度 SIP 移动平均值增长 21.7%。

服务收入增长 30.8%，达到 1.798 亿美元。四季度服务移动平均值增长 18.4%。

各地区收入 - 2024 年第二季度同比变化

按收入计算,最大的报告地区美洲在 2024 年第二季度采购了 20.349 亿美元的电子系统设计产品和服务,同比增长 25%。美洲的四季度移动平均值增长了 18.3%。

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 采购了 5.846 亿美元的电子系统设计产品和服务,增长 14.8%。欧洲、中东和非洲地区四个季度的移动平均值增长了 16.3%。

亚太地区的电子系统设计产品和服务采购额为 17.606 亿美元,增长 11.2%。亚太地区四个季度的移动平均值增长了 18.5%。(资料来源:集微网)

### 9) Q4 DRAM 市场仅 HBM 价格环比上涨

预计 2024 年第四季度 DRAM 市场的高带宽存储器 (HBM) 价格将上涨,而通用 DRAM 的价格将停滞不前。由于通用产品的低迷和进入 HBM 市场的延迟,三星电子第三季度的盈利受到冲击。许多专家表示,这家韩国半导体巨头必须认真地向人工智能 (AI) 芯片巨头英伟达供应 HBM,才能从低迷中恢复过来。

根据市场研究公司 TrendForce 的预测,今年第四季度通用 DRAM 的价格预计将比上一季度上涨 0%~5%,但随着 HBM 在 DRAM 市场所占份额的上升,包括 HBM 在内的所有 DRAM 的平均价格预计将比上一季度上涨 8%~13%。

第三季度通用 DRAM 价格的增长率为 8%~13%,但预计第四季度将停滞不前,原因是经济衰退导致消费需求放缓,以及中国存储器制造商的供应增加。存储器制造商扩大 HBM 生产将导致通用内存供应量下降,这将成为价格上涨的一个因素,但不足以抵消需求的低迷。

TrendForce 表示,预计第四季度的合约价格将下降 5%~10%。TrendForce 预计,LPDDR5X DRAM (最先进的产品和第七代芯片) 的价格将保持不变,因为其库存水平相对合适。(资料来源:集微网)

### 10) 恢复增长! 全球半导体封装材料市场预计明年达 260 亿美元

近日,SEMI、TECHCET 和 TechSearch International 在其最新的全球半导体封装材料展望 (GSPMO) 报告中宣布,受各种终端应用对半导体的强劲需求推动,全球半导体封装材料市场预计将开始增长周期,预计到 2028 年复合年增长率 (CAGR) 为 5.6%。该报告强调,尽管由于该细分市场尚属新兴,目前的单位产量较低,但人工智能仍是先进封装应用的预期增长动力。GSPMO 报告提供了基板、引线框架、键合线和其他先进封装材料的全面数据和预测。

TECHCET 总裁兼首席执行官 Lita Shon-Roy 表示:“2023 年半导体封装材料市场经历了 15.5% 的下滑,我们的最新报告预测 2024 年将恢复增长。预计到 2025 年,全球封装材料市场规模将超过 260 亿美元,并将持续稳步增长至 2028 年。”(资料来源:集微网)

### 11) NAND 闪存价格下跌，存储厂商考虑减产

由于 IT 需求低于预期，NAND 闪存的价格已经开始下滑。据报道，主要存储公司正计划调整其利用率，未来可能将投资重点转向 DRAM。三星电子、SK 海力士、美光和铠侠等主要企业正在考虑降低 NAND 利用率和削减投资的计划。

据报道，主要 NAND 生产线的利用率在 2023 年下降到 20%~30%之后，在 2024 年初短暂恢复到 80%~90%。然而，除大容量 NAND 工艺外，通用 NAND 产品的需求仍然较低，这促使企业根据市场情况逐步调整利用率。

NAND 的固定交易价格在 2023 年 10 月开始回升，但于 2024 年 3 月停止上涨，并在 2024 年 9 月出现下跌。业界担心，NAND 通用产品可能再次面临减产，有可能回到 2023 年的水平。

出现这种情况的主要原因是，尽管 IT 产品需求尚未完全恢复，但像铠侠和西部数据（WD）这样的公司，以及三星、SK 海力士和美光都开始增加 NAND 出货量，导致市场饱和。

因此，三星和 SK 海力士等同时经营 NAND 和 DRAM 的公司正在将重点转向 DRAM。目前，人工智能领域对 DRAM 产品的需求持续增长，尤其是对高带宽存储器（HBM）或 CXLDRAM 的需求，英伟达等大客户的订单持续增加。因此，存储厂商有必要提高产能。（资料来源：集微网）

### 12) 大摩：三星 HBM4 基底技术将外包台积电

据媒体报道，大摩指出，三星预计在 2026 年将 HBM4 基底技术外包给台积电，且未来 5 年有望实现 15%-20%的年均复合增长率。

大摩半导体产业分析师詹家鸿指出，三星预计在 2026 年将其 HBM4 基底技术外包给台积电，并采用 12nm/6nm 制程。台积电面临强劲需求的情况下，正积极进行产能扩张，预计在 2025 年将资本支出增加至 380 亿美元。

此外，在高效能运算（HPC）和 AI 需求的强劲增长下，台积电原先计划在 2026 年将 CoWoS 产能扩至 8 万片/月，但由于英伟达对此技术需求强劲，台积电决定将此计划提前到 2025 年底前，因此台积电未来 5 年有望实现 15%-20%的年均复合增长率。（资料来源：集微网）

### 13) 台积电 Q3 营收 7597 亿元新台币，创历史新高

台积电 10 月 9 日公布最新财报，9 月营收达 2518.73 亿元新台币（单位下同），月增 0.4%，年增 39.6%，为历年次高且为历年同期新高，主要因为受惠 5nm 及 3nm 先进制程订单持续满载。

台积电第 3 季财测汇率假设为 1 美元兑 32.5 元，预估营收区间在新台币 7280 至 7540 亿元，季增 7.6%~11.4%。按照台积电公布营收累计 7、8 月营收为 5078 亿元，

加上9月营收达到7596.92亿元，季增12.8%，创下历史单季新高，且首度突破7500亿元，符合市场预期的史上最强第3季度。（资料来源：集微网）

#### 14) 台积电美国厂试产5nm，AMD成第二大客户

AMD将在台积电位于亚利桑那州的新工厂生产高性能芯片，成为继苹果之后该工厂的第二大知名客户。记者Tim Culpan报道称，知情人士证实了这一协议，但台积电拒绝置评。

位于亚利桑那州菲尼克斯附近的台积电Fab 21已开始试产其5nm节点，该工艺节点系列包括N4/N4P/N4X和N5/N5P/N5X工艺。虽然其第一阶段的生产尚未完全开始，但苹果A16 Bionic芯片目前正在Fab 21使用N4P工艺生产。（资料来源：集微网）

#### 15) 台积电2nm等先进制程扩厂，高雄P4、P5启动环评

台积电高雄厂P1厂明年量产，P2、P3兴建及规划中，高雄市长陈其迈表示，台积电应对全球AI芯片等产品需求强劲，P3厂10月会动工，P4、P5近日启动环评进程。楠梓产业园区已成台积电重地，市民建议直接更名台积电园区。

台积电2nm P1厂预计明年量产，1500名员工年底进驻高雄，另P2厂预计明年完工，P3厂在8月通过环评，另P4、P5厂已申请设厂，用地面积41公顷。（资料来源：集微网）

## 2.2 AI

### 1) 中兴通讯、东风汽车与湖北移动联合推出AiCube汽车设计一体机

近日，在2024年中国移动合作伙伴大会上，中兴通讯展示了一款专为汽车设计行业打造的AI赋能产品——基于中兴通讯AiCube智算一体机的汽车设计应用。该产品由东风汽车、湖北移动及中兴通讯联合打造，旨在简化汽车行业的设计流程，提升设计效率和质量，以满足现代汽车制造业的多样化需求。

中兴通讯基于东风汽车提供的高质量汽车图片语料，进行了深度学习训练，打造出智能化的汽车AI设计应用。该应用特别为东风汽车定制了全新的用户界面，秉持以人为本、简洁直观的设计理念，以更好地适应行业客户的具体需求。该应用支持线稿、风格、空间关系等多种设计类型选项，允许用户进行个性化定制与优化。用户输入简单的关键词，即可生成高质量的汽车设计图像，这些图像不仅参数准确、质感出色，而且各项指标均达到了业界领先水平。（资料来源：集微网）

### 2) OpenAI将于年底前在新加坡开设亚太地区中心

OpenAI周三表示，已开始在新加坡组建团队，新加坡办事处将为该地区的客户

提供支持，重点是与政府和企业建立合作关系。

OpenAI 还宣布将在新加坡设立亚太地区办事处，作为亚太地区的运营中心。今年早些时候，该公司在东京设立了首个亚洲办事处，目前已在该地区开展业务。（资料来源：集微网）

### 3) Counterpoint: 2024Q2 AI 服务器全球市场占比达 29%

市场调查机构 Counterpoint Research 10 月 11 日发布博文，报告称 2024 年第 2 季度全球服务器市场中，AI 服务器占据所有服务器的 29%。

报告指出由于 AI 服务器的强劲需求，第 2 季度全球服务器市场产值达到 454.22 亿美元，同比增长了 35%。自 2022 年 ChatGPT 横空问世以来，AI 服务器的需求激增，推动了整个服务器市场的快速发展。

该机构称 AI 服务器提供商目前主流采用 ODM Direct(原厂直接销售)商业模式，占比为 44%。注：该模式主要由 ODM（原始设计制造商）直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，而不经传统的品牌厂商，委托生产的四大客户主要为微软、亚马逊、谷歌和 Meta。（资料来源：Techweb）

## 2.3 消费电子板块

### 1) OPPO “玩游戏时间最久”手机 OPPO K12 Plus 发布，双 11 到手价 1799 元起

10 月 12 日，OPPO 正式发布新品 OPPO K12 Plus。作为 OPPO K 系列全新力作，OPPO K12 Plus 全面升阶，搭载 OPPO 有史以来最大的 6400mAh 超耐久大电池+同档领先的长寿版 80W 超级闪充续航组合，带来超长续航能力。同时，OPPO K12 Plus 搭载第三代高通骁龙 7 移动平台，性能强大，功耗更低；全新加强的「超抗摔金刚石架构设计」，无惧跌落，十面耐摔。此外，OPPO K12 Plus 在影像、AI 及多功能 NFC 等功能配置方面软硬兼备，全面普及旗舰体验。

OPPO K12 Plus 将于 10 月 12 日 15:30 开启预订，10 月 15 日 10:00 正式全面开售，双十一到手价 1799 元起。（资料来源：集微网）

### 2) 未能满足 AI 功能期望，苹果 iPhone 16 系列或遭大幅砍单

苹果 iPhone 16 系列的销量前景或面临一定挑战。

据巴克莱银行分析师指出，对 iPhone 16 系列供应链的调查发现，因需求低于预期，苹果可能削减了第四季度 iPhone 16 系列产量，零部件采购数据表明，iPhone 16 系列大约砍单 300 万台。

此外，业内报告显示，iPhone 16 全球预订量与前代相比下滑了约 13%，市场需

求表现疲软。尽管苹果在中美韩市场初期销售迅速告罄，但这更多归因于有限的备货量，而非强劲的市场需求。

虽然苹果对 iPhone 16 系列的 AI 功能进行了重要升级，但消费者不一定买账。

摩根大通最新调查也揭示了类似的结果，尽管 iPhone 16 速度有所提升，但消费者对于其即将推出的 AI 功能并不构成主要的购买动机。（资料来源：集微网）

### 3) Q3 全球 PC 出货量同比增长 1.3%，联想第一，苹果暴跌 17.5%

Canalys 研究报告显示，2024 年第三季度，全球 PC 市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和 workstation 总出货量增长 1.3%，达到 6640 万台。笔记本（包括移动 workstation）出货量达到 5350 万台，增长 2.8%，而台式机（包括台式 workstation）的出货量则下跌 4.6%，达到 1290 万台。未来 12 个月将继续保持强劲增长。这主要因为 2025 年 10 月 Windows 10 服务终止前，仍有大量的 Windows PC 装机需求。

数据显示，2024 年第三季度，联想位居榜首，全球出货量达到 1650 万台，同比增长 2.8%；惠普紧随其后排名第二，全球出货量为 1350 万台，同比增长 0.4%；戴尔保持第三位，其出货量同比下降 4% 至 980 万台；华硕位列第四，凭借 15.8% 的同比增长成为头部厂商中增速最快的厂商；苹果则排在第五，出货量为 510 万台，同比下滑 17.5%。（资料来源：集微网）

## 2.4 汽车电子板块

### 1) 本田全球首座新能源汽车工厂正式投产

本田全球首座新能源汽车工厂东风本田汽车有限公司新能源工厂正式投产。该工厂位于武汉经济技术开发区，占地面积约 63 万平方米，将会是东风 Honda 有史以来数智化程度最高的工厂。

新工厂布置了 8 个工厂通用系统及 5 个车间专有数字化系统，实现从物流运输到生产的全过程可追溯的数字化管理，与智能排产系统相结合，极大地提高了生产效率和生产精度，形成年产 12 万辆新能源乘用车生产能力。

初期投产车型包括灵悉 L、烨 S7 等多款电动车型。本田目标到 2027 年纯电动产品阵容将达到 10 款车型，包括 2022 年发布的 e:N 系列和 2024 年发布的全新电动品牌“烨”系列车型；到 2035 年，将实现纯电动车销售占比 100%。（资料来源：集微网）

### 2) 乘联分会：9 月新能源乘用车批发 122.8 万辆，特斯拉、小米创新高

10 月 9 日晚，乘联分会发布 9 月新能源乘用车厂商批发销量快讯称，测算 9 月的全国新能源乘用车批发销量为 122.8 万辆，同比增长 48%，并预判 9 月新能源新车

渗透率继续超 50%。

乘联分会同时给出了各个车企的 9 月销量，其中，比亚迪第一，为 417603 辆；吉利挤下特斯拉位居第二，9 月销量达 91134 辆；特斯拉虽然跌至第三，但 9 月仍创下新高的 88321 辆。

第四至第十分别为：上汽通用五菱（76052 辆）、奇瑞汽车（54829 辆）、理想汽车（53709 辆）、长安汽车（46983 辆）、东风汽车（40139 辆）、赛力斯（35852 辆）、广汽埃安（35780 辆）。另外，9 月销量超 3 万辆的还有零跑汽车（33767 辆）、长城汽车（30068 辆）。（资料来源：集微网）

### 3) SNE Research: 1-8 月全球动力电池装车量 510.1GWh

10 月 7 日，韩国研究机构 SNE Research 发布了今年 1-8 月的全球动力电池装车量数据。数据显示，今年 1-8 月搭载于世界各国的电动汽车（EV、PHEV、HEV）的总电池使用量约为 510.1GWh，同比增长 21.7%。

在新能源汽车需求不断攀升的背景下，今年动力电池装车量表现十分亮眼。前 8 个月有 6 家中国企业的合计装车量均已超过 10GWh。榜单中，宁德时代、比亚迪、LG 新能源位列前三，前 8 个月的动力电池装车量分别为 189.2GWh、83.9GWh、61.8GWh。此外，欣旺达前 8 个月的动力电池装车量同比增速高达 60%，亿纬锂能同比增长 39.4%。

SNE Research 分析，在全球 OEM 之间混合动力技术竞争扩大的背景下，比亚迪推出了一次充电可行驶 2100 公里的新型混合动力汽车，正在双轨攻占纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力（PHEV）市场。比亚迪正在摆脱中国内需市场，进军亚洲和欧洲市场，快速获得份额。（资料来源：集微网）

## 2.5 面板板块

### 1) TCL 华星将于年底生产喷墨打印技术 OLED 面板

中国显示器制造商 TCL 华星计划在今年年底开始生产采用喷墨打印技术的 OLED 面板。该技术利用喷墨头喷嘴沉积红、绿、蓝色有机材料来形成 OLED 面板。

TCL 华星计划生产喷墨 OLED 面板，用于医疗设备中的 21.6 英寸屏幕。

这家中国显示器制造商将在明年扩大 OLED 面板的数量，同时可能会决定是否将喷墨打印应用于第 8.5 代（2200×2500 毫米）OLED 面板——这被称为 T8 项目，于 2020 年首次发布。（资料来源：集微网）

### 2) 传 iPhone 17 Slim 将采用新型 OLED 显示屏，以实现极薄机身

随着 iPhone Plus 销量逐年下降，苹果希望用更令人兴奋的产品来替代 Plus 系

列。传闻即将推出的 iPhone 17 Slim 是一款新的 iPhone 系列，据说价格比 Pro Max 系列还要昂贵。

新消息表明，即将推出的 iPhone 17 Slim 将采用一种新型 OLED 显示屏，可以实现极薄的机身。中国台湾品牌联咏科技（Novatek）最近推出了一款新的 TDDI OLED 面板，将触摸传感器层和显示驱动器合并为一个单元。这就是为什么它被称为 TDDI，代表触摸和显示驱动器集成。这听起来可能不是一项突破性的技术，但它可能对减少智能手机厚度以及减少几毫米至关重要。（资料来源：集微网）

### 3) iPad Pro 销量下滑，LGD 考虑转移 OLED 产能至 iPhone 面板

据报道，韩国显示大厂 LG 显示（LG Display, LGD）考虑将 iPad OLED 面板产线转换成 iPhone OLED 面板产线，透露新款 iPad Pro 销售不如预期，零组件供应链顺势减产。

知情人士称，LG 显示已向苹果提出减产计划，不过目前尚未确定，在等苹果确认。LG 显示考虑减产有两个原因：一是苹果新 iPad Pro 需求下降，第二季销量表现不错，但在第三季明显下滑；二是 LG 显示希望尽快增产 iPhone OLED 面板，以应对 iPhone 16 Pro 系列的旺盛需求。

据悉，新 iPad Pro 从 M2 芯片直接跃升至 M4 芯片，CPU 速度相比前代 iPad Pro 的 M2 提升最高达 50%。屏幕分为 11 英寸、13 英寸两个不同尺寸，11 英寸面板由 LG 显示和三星显示供应，13 英寸则由 LG 显示独家供应。（资料来源：集微网）

### 4) 传三星电子全面重组，将关闭 LED 业务

据报道，三星电子启动组织全面性重组，正在推进将研发人员全面部署到生产现场的方案，并决定关闭失去竞争力的发光二极管（LED）业务，该业务是负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门下的非核心领域。

据业内人士 10 月 10 日透露，三星电子旗下 DS 部门正在采取措施重组其 LED 业务团队。LED 业务团队一直生产电视 LED、相机闪光灯 LED 和汽车头灯 LED 零件。虽然该业务每年约能带来约 2 万亿韩元的销售额，但公司决定专注于核心领域。

三星电子计划关闭 LED 业务，专注于功率半导体和 Micro LED 业务。（资料来源：集微网）

### 5) 以旧换新及减产效应，研调：电视面板价格部分止跌

研调机构集邦科技表示，面板厂在中国十一长假期间减产，加上中国近期家电以旧换新政策带动下，10 月电视面板价格可望摆脱第 3 季需求下滑、价格全面下跌的窘境。

集邦科技研究副总经理范博毓说明，32、43 吋电视面板跌势已告尾声，近期需求不差，预计 10 月价格可望转为持平；中尺寸 50、55 吋仍是供给较多，属跌价压力较

大的尺寸，预计10月价格仍可能下跌1美元；大尺寸面板65、75吋在面板厂持续严控10.5代线稼动率，维持供需稳定，加上近期以旧换新政策提振买气，预计10月价格也有机会转为持平。

范博毓指出，液晶显示器(Monitor)面板在进入10月后，需求持续减弱，预期面板价格仍将延续9月跌价趋势，加上部分面板厂为维持出货稳定，第3季末与品牌客户谈定不少专案，也增添第4季价格下跌压力。

笔电面板部分，进入10月后，集邦评估，因为进入需求淡季，笔电面板价格在买卖双方的攻防预计将出现微妙的变化。部分品牌客户开始要求面板价格下跌，以对应需求减少及库存升高。(资料来源：集微网)

### 三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比(%)
300736.SZ	百邦科技	2024-10-10	增持	刘铁峰	实际控制人董事长		
688262.SH	国芯科技	2024-10-09	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5%以下股东	2,015,999.00	0.60
688262.SH	国芯科技	2024-10-09	减持	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	551,994.00	0.16
688262.SH	国芯科技	2024-10-09	减持	西藏津盛泰达创业投资有限公司	5%以下股东	1,341,006.00	0.40
688262.SH	国芯科技	2024-10-09	减持	魏宏锐	5%以下股东	630,273.00	0.19
688262.SH	国芯科技	2024-10-09	减持	天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	310,215.00	0.09
301366.SZ	一博科技	2024-10-08	减持	深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	持股5%以上股东	1,488,405.00	1.00
603679.SH	华体科技	2024-10-09	减持	王绍兰	其他股东:实际控制人之一致行动人	1,154,332.00	0.71
603679.SH	华体科技	2024-10-09	减持	王蓉生	其他股东:实际控制人之一致行动人	269,000.00	0.16
002962.SZ	五方光电	2024-10-10	减持	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	控股股东,实际控制人的一致行动人	2,688,400.00	0.92
688662.SH	富信科技	2024-10-12	减持	曹卫强	董事,监事,高级管理人员	28,125.00	0.03
688662.SH	富信科技	2024-10-12	减持	罗嘉恒	董事,监事,高级管理人员	15,000.00	0.02
301045.SZ	天禄科技	2024-10-08	减持	马长建	持股5%以上股东	600,000.00	0.54
603933.SH	睿能科技	2024-10-10	增持	赵健民	董事,副总经理	50,000.00	
603933.SH	睿能科技	2024-10-10	增持	蓝李春	董事,副总经理,董事会秘书	30,000.00	
603933.SH	睿能科技	2024-10-10	增持	王开伟	董事	50,000.00	

603933.SH	睿能科技	2024-10-10	增持	张香玉	财务总监	50,000.00	
603933.SH	睿能科技	2024-10-10	增持	张国利	副总经理	30,000.00	
688381.SH	帝奥微	2024-10-09	减持	江苏润友投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	2,522,000.00	1.00
688381.SH	帝奥微	2024-10-10	减持	北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙),北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	2,522,000.00	
001287.SZ	中电港	2024-10-08	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	股东	1,953,080.00	0.26
001287.SZ	中电港	2024-10-08	减持	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	股东	1,302,053.00	0.17
001287.SZ	中电港	2024-10-08	减持	中电坤润基金和中电发展基金	股东	1,831,337.00	0.24
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	孙东丰	董事, 监事, 高级管理人员	9,620.00	0.01
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	宗润福	董事, 监事, 高级管理人员	560,000.00	0.41
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	李凤莉	董事, 监事, 高级管理人员	311,200.00	0.23
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	程虎	董事, 监事, 高级管理人员	11,100.00	0.01
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	陈兴隆	董事, 监事, 高级管理人员	26,900.00	0.02
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	顾永田	董事, 监事, 高级管理人员	31,400.00	0.02
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	汪明波	董事, 监事, 高级管理人员	14,900.00	0.01
688037.SH	芯源微	2024-10-09	减持	崔晓微	董事, 监事, 高级管理人员	31,700.00	0.02
688130.SH	晶华微	2024-10-09	增持	吕汉泉	控股股东, 实际控制人, 董事长		
300184.SZ	力源信息	2024-10-10	减持	高惠谊	控股股东的一致行动人	11,540,119.00	1.00
300709.SZ	精研科技	2024-10-12	减持	常州创研投资咨询有限公司	控股股东, 实际控制人的一致行动人	1,860,766.00	1.00
300936.SZ	中英科技	2024-10-08	减持	顾书春	董事, 副总经理	59,075.00	0.08
688469.SH	芯联集成-U	2024-10-10	减持	共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	20,082,927.00	0.29
688469.SH	芯联集成-U	2024-10-10	减持	共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	40,165,853.00	0.57
688469.SH	芯联集成-U	2024-10-10	减持	共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	20,082,927.00	0.29
870357.BJ	雅葆轩	2024-10-12	减持	孙昌来	持股5%以上股东	800,800.00	1.00

300752.SZ	隆利科技	2024-10-09	减持	上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私募基金合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上	2,252,434.00	1.00
300752.SZ	隆利科技	2024-10-09	减持	康健	持股 5%以上	2,252,434.00	1.00
688107.SH	安路科技	2024-10-11	减持	深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,000,000.00	0.25
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	唐飞	副总经理	15,000.00	0.00
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	顾为群	副总经理	15,000.00	0.00
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	纪安宽	副总经理	15,000.00	0.00
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	李延辉	副总经理,财务总监	15,000.00	0.00
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	王晓宁	副总经理,董事会秘书	10,000.00	0.00
002371.SZ	北方华创	2024-10-12	减持	夏威	副总经理	10,000.00	0.00
688515.SH	裕太微-U	2024-10-09	减持	李海华	5%以上非第一大股东	1,200,000.00	1.50
688515.SH	裕太微-U	2024-10-11	减持	李海华	5%以上非第一大股东	800,000.00	1.00
688048.SH	长光华芯	2024-10-10	减持	张玉国	董事,监事,高级管理人员	65,000.00	0.04
688048.SH	长光华芯	2024-10-10	减持	谭少阳	董事,监事,高级管理人员	26,260.00	0.01
603501.SH	韦尔股份	2024-10-12	减持	虞仁荣	控股股东	25,000,000.00	2.06
301486.SZ	致尚科技	2024-10-11	减持	刘东生	持股 5%以上股东	3,822,409.00	3.00
600745.SH	闻泰科技	2024-10-09	减持	珠海格力电器股份有限公司	5%以下股东	12,428,097.00	1.00
002156.SZ	通富微电	2024-10-12	减持	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	大股东	45,527,907.00	3.00
688234.SH	天岳先进	2024-10-09	减持	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	9,103,470.00	2.12
688234.SH	天岳先进	2024-10-09	减持	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	5%以下股东	2,825,783.00	0.66
688234.SH	天岳先进	2024-10-09	减持	海通创新证劵投资有限公司	5%以下股东	962,077.00	0.22
002741.SZ	光华科技	2024-10-12	增持	郑勃	控股股东,实际控制人,总经理		
688535.SH	华海诚科	2024-10-11	减持	江苏新潮创新投资集团有限公司	5%以下股东	2,258,197.00	2.80
605277.SH	新亚电子	2024-10-10	减持	海南历信创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	9,521,710.00	3.00
832491.BJ	奥迪威	2024-10-10	减持	惠州市创新投资有限公司	持股 5%以上股东的一致行动人	1,812,607.00	1.28
688538.SH	和辉光电-U	2024-10-09	减持	上海集成电路产业投资基金股份有限公司,上海科技创业投资(集团)有限公司	5%以上非第一大股东	276,640,000.00	2.00
688512.SH	慧智微-U	2024-10-10	减持	GZPAHoldingLimited	5%以下股东	4,607,625.00	1.00
301348.SZ	蓝箭电子	2024-10-08	减持	上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上股东	2,000,000.00	1.00

301348.SZ	蓝箭电子	2024-10-08	减持	广东比邻投资基金管理有限公司-比邻创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股东	2,000,000.00	1.00
688484.SH	南芯科技	2024-10-09	减持	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	5%以上非第一大股东	4,254,577.00	1.00
688484.SH	南芯科技	2024-10-09	减持	顺为科技,杭州顺赢,武汉顺赢,武汉顺宏	5%以上非第一大股东	17,018,309.00	4.00
300909.SZ	汇创达	2024-10-11	减持	段志军	一致行动人	461,760.00	0.27
300909.SZ	汇创达	2024-10-11	减持	段志刚	董事	577,200.00	0.33
300223.SZ	北京君正	2024-10-08	减持	北京屹唐盛芯半导体产业投资中心(有限合伙)	持股5%以上股东	800,000.00	0.17
688173.SH	希荻微	2024-10-11	减持	深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	12,309,273.00	3.00
688286.SH	敏芯股份	2024-10-09	减持	上海华芯创业投资企业	5%以上非第一大股东	839,349.00	1.50

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数(万)	激励总数占当时总股本比例(%)	期权初始行权价格
300232.SZ	洲明科技	2024-10-09	股东大会通过	上市公司定向发行股票	2,400.00	2.2031	3.50
688130.SH	晶华微	2024-10-11	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	151.00	1.6241	11.30
688432.SH	有研硅	2024-10-11	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	1,235.00	0.9899	9.11

数据来源: Wind, 华福证券研究所

#### 四、 风险提示

技术发展及落地不及预期; 下游终端出货不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧风险; 地缘政治风险; 行业景气不及预期。

## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

## 特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

## 联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn